



关于

《关于广东鼎泰高科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》

之回复报告

保荐人（主承销商）



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

深圳证券交易所：

贵所于 2022 年 2 月 21 日出具的《关于广东鼎泰高科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函（2022）010202 号）（以下简称“《审核中心意见落实函》”）收悉，中信证券股份有限公司作为保荐人和主承销商，与发行人、发行人律师及发行人会计师对《审核中心意见落实函》所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。

说明：

一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与招股说明书（申报稿）中的相同。

二、本回复报告中的字体代表以下含义：

黑体（不加粗）：	审核中心意见落实函所列问题
宋体（不加粗）：	对审核中心意见落实函所列问题的回复
楷体（加粗）：	对招股说明书（申报稿）的修改
楷体（不加粗）：	对招股说明书（申报稿）的引用

目 录

目 录.....	2
问题 1、行业政策对发行人的影响.....	3
问题 2、关于财务事项.....	7

问题 1、行业政策对发行人的影响

申请文件及问询回复显示，发行人下游业务主要系 PCB 相关行业，受国家半导体产业政策的影响较大。

请发行人分析说明近年来国家半导体产业政策的变动情况，半导体产业政策调整对发行人持续经营能力的影响，未来会否发生重大不利变化。

请保荐人、发行人律师发表明确意见。

回复：

一、补充说明

（一）发行人分析说明近年来国家半导体产业政策的变动情况

半导体产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会信息化的重要基础，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。国家为推动国内半导体产业的发展，增强信息产业的创新能力和国际竞争力，出台了一系列鼓励扶持政策，为半导体产业建立了优良的政策环境，具体如下：

序号	文件名称	发布时间	发布单位	主要内容
1	《“十四五”智能制造发展规划》	2021 年 4 月	工信部	规划指出，推进智能制造，关键要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链和产业集群等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效的智能制造系统。到 2025 年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到 2035 年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。
2	《中华人民共和国工业和信息化部国家发展改革委财政部国家税务总局公告》（2021 年第 9 号）	2021 年 4 月	工信部、发改委、财政部、国税总局	将《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》国发[2020]8 号》第二条所称国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件明确。
3	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	2021 年 3 月	发改委	纲要指出，需要集中优势资源攻关多领域关键核心技术，其中集成电路领域包括集成电路设计工具开发、重点装备和高纯靶材开发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极晶

序号	文件名称	发布时间	发布单位	主要内容
				体管(IGBT)、微机电系统(MEMS)等特色工艺突破,先进存储技术升级,碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展。
4	《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》(发改高技[2021]413号)	2021年3月	发改委、工信部、财政部、海关总署、国税总局	明确了享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业条件和标准。
5	《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》	2020年12月	财政部、国家税务总局、发改委、工信部	国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。
6	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	2020年7月	国务院	国家鼓励的先进封装测试企业给与财税、投融资、研发、进出口人才、知识产权等方面的优惠政策。
7	《广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》	2020年2月	广东省人民政府办公厅	该政策明确指出,要积极发展封测、设备及材料,完善产业链条,积极推进缺陷检测设备、激光加工设备 etc 等整机设备的研发生产。
8	《产业结构调整指导目录(2019年本)》	2019年10月	发改委	鼓励类产业中包括球栅阵列封装(BGA)、插针网格阵列封装(PGA)、芯片规模封装(CSP)、多芯片封装(MCM)、栅格阵列封装(LGA)、系统级封装(SiP)、倒装封装(FC)、晶圆级封装(WLP)、传感器封装(MEMS)等先进封装与测试。
9	《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》	2019年5月	财政部、税务总局	依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业,在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。
10	《粤港澳大湾区发展规划纲要》	2019年2月	国务院	该政策明确指出要培育壮大战略性新兴产业,高性能集成电路领域在此战略性新兴产业中,进而有利于半导体器件专用设备制造业的发展。
11	《战略性新兴产业分类(2018)》	2018年11月	国家统计局	将集成电路制造业列为国家战略性新兴产业,对应《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2017)中的半导体器件专用设备制造。

序号	文件名称	发布时间	发布单位	主要内容
12	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》	2017年1月	发改委	重点支持电子核心产业，包括集成电路芯片封装，采用 SiP、MCP、MCM、CSP、WLP、BGA、Flip Chip（倒装封装）、TSV 等技术的集成电路封装。
13	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	2016年12月	国务院	启动集成电路重大生产力布局规划工程，实施一批带动作用强的项目，推动产业能力实现快速跃升。加快先进制造工艺、存储器、特色工艺等生产线建设，提升安全可靠 CPU、数模/模数转换芯片、数字信号处理芯片等关键产品设计开发能力和应用水平，推动封装测试、关键装备和材料等产业快速发展。
14	《“十三五”国家科技创新规划》	2016年7月	国务院	攻克 14 纳米刻蚀设备、薄膜设备、掺杂设备等高端制造装备及零部件，突破 28 纳米浸没式光刻机及核心部件，研制 300 毫米硅片等关键材料，研发 14 纳米逻辑与存储芯片成套工艺及相应系统封测技术，开展 75 纳米关键技术研究，形成 28-14 纳米装备、材料、工艺、封测等较完整的产业链，整体创新能力进入世界先进行列。
15	《中国制造 2025》	2015年5月	国务院	将集成电路作为“新一代信息技术产业”纳入大力推动发展的重点领域，着力提升集成电路设计水平，掌握高密度密封及三维微组装技术，提升封装产业和测试的自主发展能力，形成关键制造设备供货能力。

（二）半导体产业政策调整对发行人持续经营能力的影响，未来会否发生重大不利变化

根据全球半导体贸易统计组织的数据，2020 年全球半导体销售额达到 4,403.89 亿美元，同比增长 6.81%。随着国内经济不断发展以及国家政策层面对半导体行业的大力支持，我国半导体产业快速发展，产业规模迅速扩大，技术水平显著提升，有力推动了国家信息化建设。根据中国半导体行业协会统计，2020 年中国集成电路产业销售额为 8,848.00 亿元，同比增长 17.00%。

IC 载板主要应用于半导体封装环节，目前半导体行业景气度升至高位，带动 IC 载板需求提升。根据 Prismark 数据，2020 年 IC 载板行业产值已达到 102 亿美元，预计 2025 年 IC 载板行业产值达到 162 亿美元，2020-2025 年的复合增

长率为 9.69%。报告期内公司客户深南电路、兴森科技等 IC 载板行业知名厂商的相关业务收入高速增长，根据公开披露信息，深南电路 IC 载板业务 2020 年实现营业收入 15.44 亿元，同比增长 32.67%，收入占比为 13.31%，**2021 年实现营业收入 24.15 亿元，同比增长 56.35%，收入占比为 17.32%**；兴森科技 IC 载板业务 2020 年实现收入 33,615.89 万元，同比增长 13%，收入占比为 8.33%，2021 年上半年实现收入 29,543.76 万元，同比增长 111.06%，收入占比为 12.46%。

半导体产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会信息化的重要基础，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。结合《“十四五”智能制造发展规划》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等政策，未来一段时间内国家仍将持续积极推动半导体产业的发展，相关政策在短期内发生重大不利变化的风险较小。

公司的钻针、铣刀等产品属于 PCB 加工制造专用的耗材，PCB 广泛应用于通信、消费电子、汽车、医疗器械、工业控制等电子信息产业，具有广阔的市场空间和良好的发展前景。IC 载板等高端 PCB 为半导体产业链不可或缺的一环，未来即使国内半导体行业政策的支持力度发生变化，对整个 PCB 行业乃至电子信息产业的市场需求影响预计较为有限。公司作为 PCB 刀具龙头企业，与国内外知名 PCB 生产厂商建立了长期稳定的合作关系，并且公司产品种类丰富、产品型号齐全、应用领域范围广，大大提升公司应对政策风险的能力，确保能够通过调整产品结构、营销组合等方式来稳步推进公司的发展。

综上，国家一系列鼓励扶持政策不断推动半导体产业的发展，带动 IC 载板市场需求以及相关厂商经营业绩的提升，为公司钻针等产品提供了更为广阔的市场空间；半导体产业政策短期内发生重大不利变化的风险较小，即使未来相关政策发生调整，对整个电子信息产业及 PCB 行业的影响预计较为有限，且公司应对政策风险的能力较强，未来公司持续经营能力受到重大不利影响的可能性较小。

发行人已在招股说明书“第四节 风险因素”之“三、经营风险”中补充披露如下：

“(二) 行业政策风险

发行人钻针、铣刀等产品属于 PCB 加工制造专用的耗材，PCB 为电子信息产

业中重要的组成部分，主要应用于 5G、新能源汽车、半导体等领域。PCB 行业及相关应用领域均受到国家产业政策的大力支持，目前行业发展前景良好，但随着市场环境逐步成熟，市场化程度逐步提高，市场规模扩大，国家相关产业政策未来存在调整的可能性，有可能对公司业务的发展造成一定的影响。”

二、核查情况

（一）核查程序

保荐人及发行人律师履行了以下核查程序：

查阅并了解半导体行业的行业法规、产业政策、研究报告及统计数据；查阅公开披露信息，访谈公司技术、销售人员以及公司主要客户，了解 IC 基板生产环节对钻针等刀具产品的应用，分析半导体产业政策情况对于公司持续经营能力的影响。

（二）核查结论

经核查，保荐人及发行人律师认为：

国家为推动国内半导体产业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，出台了一系列鼓励扶持政策，为半导体产业建立了优良的政策环境，带动 IC 载板市场需求以及相关厂商经营业绩的提升，为公司钻针等产品提供了更为广阔的市场空间；半导体产业政策短期内发生重大不利变化的风险较小，公司应对政策风险的能力较强，未来公司持续经营能力受到重大不利影响的可能性较小；发行人已在招股说明书中补充完善相应风险提示。

问题 2、关于财务事项

申请文件及问询回复显示：

（1）发行人将委托加工物资通过存货-在产品科目进行核算，发行人各期委托加工金额较小，除前述因委托加工核算的在产品外，发行人各期在产品账面余额占存货比重约为 15%左右，招股说明书显示钻针和铣刀的生产流程较短。

（2）发行人报告期内主要产品毛利率变动受原材料成本影响较大。2020 年，发行人钻针产品的单位材料成本同比大幅下滑，当期采购的主要原材料钨钢价格

未出现大幅下滑。

请发行人：

(1) 结合具体在产品的生产过程、涉及的工序及生产周期，期末备货安排及在手订单情况，说明报告期各期末在产品占存货整体比例较大的原因。

(2) 说明发行人单位成本下降滞后于原材料价格变动的背景；结合发行人生产周期、销售周期及存货结转情况，进一步说明发行人单位成本变动与原材料采购价格变化的匹配关系。

请保荐人、申报会计师发表明确意见。

回复：

一、补充说明

(一) 结合具体在产品的生产过程、涉及的工序及生产周期，期末备货安排及在手订单情况，说明报告期各期末在产品占存货整体比例较大的原因。

1、发行人各期末的在产品主要是钻针、铣刀

发行人在产品余额主要为各生产环节中未完工的半成品，以及少量委托外协供应商进行涂层、包胶等加工的委托加工物资，各期末在产品按照产品进行分类，主要是钻针、铣刀（占比约 90%），各期列示如下：

单位：万元

在产品对应的产品	2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
钻针	3,832.94	75.71%	3,199.54	77.12%	2,690.59	81.49%
铣刀	756.09	14.94%	479.29	11.55%	240.18	7.27%
数控刀具	64.74	1.28%	100.73	2.43%	72.94	2.21%
PCB 刀具	22.31	0.44%	25.96	0.63%	9.16	0.28%
刷磨轮	103.81	2.05%	56.75	1.37%	47.74	1.45%
自动化设备	244.87	4.84%	204.69	4.93%	194.71	5.90%
功能性膜产品	6.21	0.12%	81.57	1.97%	45.87	1.39%
其他	31.47	0.62%	-	-	0.47	0.01%
小计	5,062.43	100.00%	4,148.55	100.00%	3,301.66	100.00%

随着发行人产能和销量的增加，原材料投料增加，各期末在产品余额呈上升

趋势。

2、发行人各期末在产品占存货整体比例较大，符合公司的生产特点

发行人的产品主要是钻针和铣刀，该等产品为标准化产品，其对应的在产品开槽工序之前具有一定的通用性，发行人可根据客户的订单内容将在产品加工成不同的最终产成品进行销售。此外，鉴于客户要求的交货时间较短（一般为接单后 2-3 天发货），发行人为保证生产和供货的及时、稳定，会根据市场调研和订单情况进行备货式生产，保证一定的在产品库存，导致各期末在产品占存货整体比例较大，符合公司的生产特点。

钻针和铣刀涉及的主要生产工序及生产周期情况如下：

钻针的主要工序	生产周期（天）	铣刀的主要工序	生产周期（天）
焊接	3.5	刃加工	1.0
柄加工	0.5	清洗	0.5
刃加工	1.0	开槽	1.5
开槽磨尖	3.0	清洗	0.5
清洗	0.5	成品检测	1.0
成品检测	1.0		
小计	9.5	小计	4.5

注 1：生产周期，系按整张工单的生产工时计算。

注 2：钻针工序中焊接包括切断、热处理、去毛刺等流程。

注 3：铣刀需要切鱼尾、研磨和清洗工序的产品比较少，故未统计。

报告期各期末，钻针和铣刀在产品对应产成品的数量比例关系稳定，周转较快，其中钻针的在产品数量基本对应 2.5 个月的产成品产量，铣刀的在产品数量基本对应 1.5 个月的产成品产量，具体如下：

产品	项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
钻针	产成品产量（万支）	64,536.38	52,039.39	36,538.97
	产成品月产量（万支）	5,378.03	4,336.62	3,044.91
	期末在产品数量（万支）	14,813.55	10,677.43	8,720.82
	在产品对应的产成品产量月份数	2.75	2.46	2.86
铣刀	产成品产量（万支）	6,481.14	4,193.75	2,134.29
	产成品月产量（万支）	540.09	349.48	177.86
	期末在产品数量（万支）	700.28	560.30	222.39

产品	项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
	在产品对应的产成品产量月份数	1.30	1.60	1.25

3、发行人备货式生产未导致存货长期滞销

由于公司的在产品具有通用性，且主要产品生产周期较短，为连续性生产，故通过计算在手订单金额对库存商品的覆盖情况分析各期末存货金额的合理性，具体如下：

单位：万元

项目	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
①库存商品账面余额	10,424.25	9,713.82	7,349.84
②在手订单金额（不含税）	4,974.27	4,219.73	2,899.25
在手订单覆盖率（②/①）	47.72%	43.44%	39.45%

发行人报告期各期末，覆盖率分别为 39.45%、43.44% 和 **47.72%**，覆盖率逐年增加。而且，库存商品期后销售结转正常（半年内结转比例约 85%），说明发行人备货式生产不存在长期滞销的情形。

（二）说明发行人单位成本下降滞后于原材料价格变动的背景；结合发行人生产周期、销售周期及存货结转情况，进一步说明发行人单位成本变动与原材料采购价格变化的匹配关系

报告期内，公司主要产品钻针的单位成本及其主要原材料钨钢的采购单价如下：

单位：元/支

项目	2021 年		2020 年		2019 年
	金额	变动率	金额	变动率	金额
钻针单位平均成本	/	-1.22%	/	-10.24%	/
其中：单位直接材料成本	/	-14.71%	/	-12.77%	/
主要原材料采购单价	/	/	/	/	/
钻针-进口钨钢	/	-9.91%	/	-13.90%	/
钻针-国产钨钢	/	-31.04%	/	-28.32%	/

注 1：公司采购的进口钨钢规格以长支为主（333L，“L”为长度，单位为“毫米”），采购的国产钨钢规格包括短支、长支（13.1L、38.3L、330L 等）；

注 2：钻针单位成本、主要原材料采购单价已按照要求申请豁免披露。

钨钢为钻针产品的主要原材料。钨钢的市场价格主要受大宗商品钨与钴市场

价格波动、下游市场供需及竞争情况的影响。钨与钴市场价格于 2019-2020 年呈下降趋势，2021 年起价格逐步有所上升；近年来下游终端电子产品单价有所下滑，价格变动传导至原材料；由于公司通常与供应商按年度或不定期签订协议，该期间内供应价格不发生变动，因此相对于大宗商品钨与钴市场价格，原材料钨钢价格走势具有延后性。受上述因素影响，报告期内公司钴针产品所采购钨钢价格整体呈下滑趋势。

公司钴针产品单位直接材料成本主要受原材料采购价格影响，原材料采购均价和产品直接材料成本的变动趋势基本一致，如 2021 年公司钴针产品所采购的进口钨钢单价同比下降 9.91%，所采购的国产钨钢单价为同比下降 31.04%，钴针单位直接材料成本同比下降 14.71%；2020 年公司钴针产品所采购的进口钨钢单价同比下降 13.90%，所采购的国产钨钢单价同比下降 28.28%，钴针单位直接材料成本同比下降 12.77%。

公司钴针产品自采购入库至销售结转的周期合计约 4 个月，故公司 2020 年全年平均钴针直接材料成本与 2019 年 9 月至 2020 年 8 月的原材料平均采购价格的相关性较强。具体比较情况如下：

项目	2020 年		2019 年
	金额	变动率	金额
钴针单位平均成本	/	-10.24%	/
其中：单位直接材料成本	/	-12.77%	/
项目	2019 年 9 月至 2020 年 8 月		2018 年 9 月至 2019 年 8 月
	金额	变动率	金额
主要原材料采购单价	/	/	/
钴针-进口钨钢	/	-16.06%	/
钴针-国产钨钢	/	-34.56%	/

注：钴针单位成本、主要原材料采购单价已按照要求申请豁免披露。

2019 年 9 月至 2020 年 8 月公司钴针产品所采购的进口钨钢单价同比下降 16.06%，所采购的国产钨钢单价同比下降 34.56%，2020 年钴针单位直接材料成本同比下降 12.77%。报告期内公司钴针原材料钨钢中的进口钨钢采购金额占比为 70-80%，相对于国产钨钢，进口钨钢的采购价格变动对直接材料成本的影响更大。公司 2020 年全年平均钴针直接材料成本与 2019 年 9 月至 2020 年 8 月公

司原材料平均采购价格的变动趋势基本一致，钴针产品单位直接材料成本的下降幅度低于上述期间公司原材料钨钢采购价格的下降幅度，主要系同期不锈钢丝等其他原材料价格上升，以及因产品规格型号变化导致的 2020 年钨钢平均单耗上升所致。

综上，报告期内公司主要产品钴针单位直接材料成本变动与主要原材料采购价格变化情况基本匹配。

二、核查情况

（一）核查程序

保荐人及申报会计师履行了以下核查程序：

1、获取发行人各期末在产品的明细表，了解在产品的生产过程、涉及的工序及生产周期，以及公司备货安排和在手订单情况；

2、获取报告期各期公司主要产品钴针单位成本资料及主要原材料钨钢的采购单价，分析报告期各期原材料采购价格、钴针单位成本的变化情况；向公司采购、生产、销售人员了解钴针产品自采购入库到销售结转的周期等信息，分析公司钴针产品单位成本变动与原材料采购价格变化的匹配关系。

（二）核查结论

经核查，保荐人及申报会计师认为：

1、发行人的在产品主要是钴针、铣刀，鉴于客户的交货时间较短，同时，因是标准类产品且在产品具有一定的通用性，故发行人采用备货式生产，导致各期末在产品占存货整体比例较大，符合公司的生产特点；

2、报告期内公司生产钴针产品所采购主要原材料钨钢价格与主要产品钴针单位直接材料成本变动情况基本匹配。

(本页无正文，为《关于<关于广东鼎泰高科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函>之回复报告》之发行人签章页)

广东鼎泰高科技股份有限公司



2012年 4月 13日

发行人董事长声明

本人已认真阅读广东鼎泰高科技股份有限公司本次审核中心意见落实函回复报告的全部内容，确认本次审核中心意见落实函回复报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

发行人董事长：



王 馨

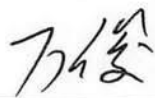


广东鼎泰高科技股份有限公司

2022年 4 月 13 日

(本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《关于<关于广东鼎泰高科技技术股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函>之回复报告》之签署盖章页)

保荐代表人：



万俊



曾劲松



保荐机构董事长声明

本人已认真阅读广东鼎泰高科技股份有限公司本次审核中心意见落实函回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，审核中心意见落实函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：


张佑君

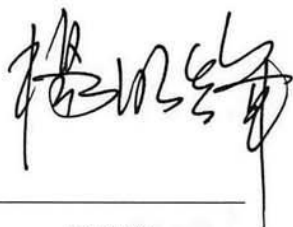


2022年4月13日

保荐机构总经理声明

本人已认真阅读广东鼎泰高科技股份有限公司本次审核中心意见落实函回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，审核中心意见落实函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理：



杨明辉



2022年4月13日